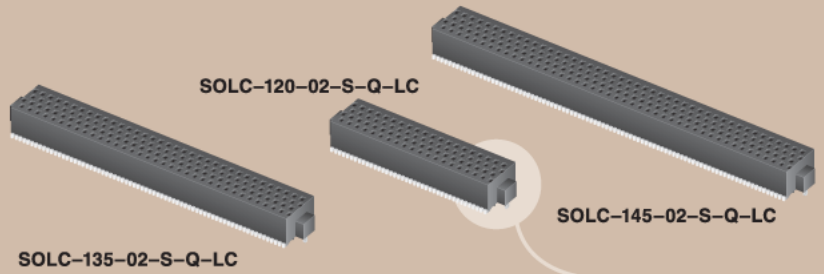


四排插座 SOLC 系列



技术规范

如需了解所有规格以及所建议的 PCB 设计, 请访问
www.samtec.com?SOLC

绝缘体材料:

黑色液晶聚合物

接头材料:

磷铜

电流额定值:

2.5A @ 80°C 环境

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

电镀:

50μ" (1.27μm) 的镍底上镀金

接触电阻:

最大 10mΩ

插入深度:

(1.68mm) .066" 至

(3.61mm) .142" 具有

(0.38mm) .015" 的拭接

插入力:

平均 2.0oz (0.56N)

标准力:

平均 75 克 (0.74N)

引离力:

平均 1.5oz (0.42N)

插拔次数:

100+

符合RoHS标准:

可

工艺处理:

最大加工温度:

230°C 时 60 秒或 260°C

时 20 秒 3 次

无铅可焊性:

可

SMT 引线共面度:

(0.10mm) .004" 最大 (05-35)

(0.15mm) .006" 最大 (40-50)

配对: TOLC



表面贴装

在与 TOLC 配对时用于
 FOLC/MOLC 的活动替换

(1.27mm)
 .050"
 微节距

独特的冲压接头,
 不要求二次成型操作

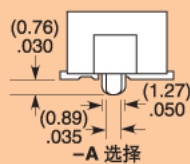
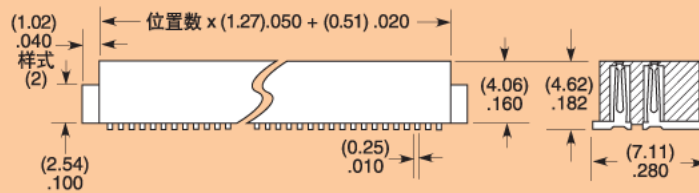
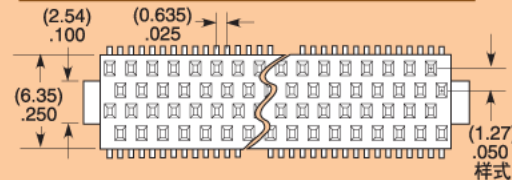


可选锁定钩

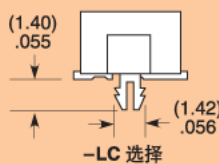
SOLC - 1 每排针脚数 - 02 电镀选择 - Q - 其他选择

05, 10, 15, 20, 25,
 30, 35, 40, 45, 50

(请致电 Samtec 了解其它型号的有关信息)



-A 选择



-LC 选择



-P 选择

-S

= 30μ" (0.76μm) 接头上镀金,
 在引线上镀半金

-L

= 10μ" (0.25μm) 接头上镀金,
 在引线上镀半金

-F

= 接头上镀半金,
 在引线上镀半金

-A

= 定位针

-LC

= 锁定钩

-K

(最佳成本选项)
 = (7.00mm) .276" 直径
 聚酰胺薄膜取放垫

-P

= 塑料取放垫

-TR

= 带卷式包装

提供带卷式包装

不收取加工费用。

最小订单为125片。

高于上述最小数量的任何订单,
 都将在公司内部设计和制造,
 快速投向市场。

请致电 Samtec 了解有关
 技术规范和订购的信息。

注: 有些尺寸, 式样和选件
 是非标准的, 不可退换。